

【起因・判断ポイント・発生工程】多層板のスルーホール用穴あけ加工後、内層接続信頼性を高めるための樹脂部の溶解除去が過多となったためできたもの（デスマア処理～スルーホール銅めっき工程）

【原因、判断要点、発生工序】在多层板的钻孔后，为了提高内层连接的可靠性，溶解去除树脂太多所引起的（除钻污～通孔电镀工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
The defective shape is formed by the excessive removal of laminate resin after multilayer through-hole drilling, which is intended to improve the reliability of internal layer connections.

5-1-2-5 逆エッチバック形状スルーホール／反向凹蚀的通孔 / Negative-etchback-shaped PTH side wall

【特徴】スルーホール内壁が内層導体部でリング状に凹んでいる状態の欠陥

【特征】在内层导线部位的通孔内壁有环状凹陷的缺陷。

【Characteristics】Sidewall of a PTH wall has a ring-shaped recession at the inner layer conductor.

【起因・判断ポイント・発生工程】多層板のスルーホール用穴加工後のデスマア処理で逆エッチバック状になったことにより出来たもの（デスマア処理～スルーホール銅めっき工程）

【原因、判断要点、発生工序】在多层板钻孔后，除钻污处理时内层导线被咬掉，成为反向凹蚀而引起的（除钻污～通孔电镀工序）。

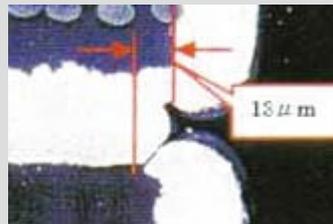
【Causes/processes involved/keys to judgment】
Excessive desmear after drilling holes for multilayer board causes the negative-etchback-shaped defect. (Desmear - through hole copper plating)



【コメント】
内層導体がスルーホール外壁より深く食われている
顕微鏡倍率×

【注釋】
内层导线被通孔外壁咬掉
显微镜倍率 ×

【Comments】
Inner layer conductor is deeply etched from the sidewall of a PTH.
Magnification: ×



【コメント】
左の拡大
顕微鏡倍率×

【注釋】
左图的放大
显微镜倍率 ×

【Comments】
Enlargement of left photo
Magnification: ×